

Amkor の最先端パッケージングが未来の自動車を実現

テンピ（アリゾナ州） -- 2023 年 6 月 13 日 -- 半導体パッケージングとテストサービスの大手プロバイダーである Amkor Technology, Inc.（NASDAQ：AMKR）は、未来の自動車を実現するための最先端パッケージングの革新に取り組んでいます。

この数年、車載半導体の売上高は増加し、自動車における様々な機能の進化は目覚ましいものがあります。2015 年の車載半導体市場は約 300 億ドルでしたが、以降、2022 年には 2 倍以上の 680 億ドルに拡大し、今後数年間は年平均成長率 10% 台半ばでの成長が続くと予想されており、半導体業界の中でも最も高い成長率を誇るセグメントの一つです。このような急成長の要因としては、自動運転機能、デジタル制御システム、自動車の電動化に対する需要の高まりが挙げられます。Amkor は、40 年以上にわたる車載用 OSAT のリーディングカンパニーとして、グローバルなサプライチェーンを支える幅広い拠点展開を強みに、自動車産業における車載用半導体コンテンツの加速度的な普及による成長を捉える有利な立場にあります。

先進運転支援システム（ADAS）や完全自動運転への移行により、地域の法律や消費者のニーズに合わせ、自動車メーカーは安全性や利便性を高める機能をベースモデルに標準搭載するようになりました。高度なパッケージングソリューションには、駐車支援、車線認識、衝突回避などのドライビングプロセスを自動化する ADAS が含まれます。ADAS テクノロジーは、レーダー、LIDAR、超音波、画像センサーなどの複数のセンサーを使用して車両の安全性を向上させます。ワイヤボンドが車載用パッケージの主流であり続ける一方で、ADAS モジュールでは、フリップチップ BGA、ウェハーレベルのファンアウト、フリップチップ CSP などの高度な相互接続テクノロジーの採用が進んでいます。ADAS プロセッサ向けの高度なシリコンノードは急速に成長しており、Amkor ではすでに 7nm が生産されており、まもなく 5nm ソリューションを車載用途に採用されることが計画されています。

ハンドルを握る消費者は、楽しくて有益、没入型でインタラクティブな車内体験を求めています。こうしたデジタルコントロールセンターの需要に応えるため、Amkor はシームレスな接続性、直感的なインターフェース、パーソナライズされた体験を提供する最先端のインフォテインメント・テレマティクスパッケージソリューションの開発を続けています。これらのソリューションには、フリップチップ、システム・イン・パッケージ、MEMS、センサーなどがあり、インパネルディスプレイやヘッドアップディスプレイ、ナビゲーションシステム、V2X（自動車とあらゆるものの通信技術）などの高度な機能を実現します。

世界各国の政府が排出量削減や持続可能な輸送を促進するための政策を実施する中で、自動車の電動化へのシフトが急速に進んでいます。Amkor は、バッテリーから電気駆動モーターへの電力変換を管理する xEV ソリューションと、電気自動車以外の燃料消費と排出量の管理と削減に使用されるパワートレインソリューションで、こうした需要の高まりに応えています。Amkor は、現在および将来の持続可能で効率的な自動車のニーズを実現するために、炭化ケイ素パワーデバイスおよびモジュールおよび MEMS テクノロジーの高度なパッケージングで業界をサポートし続けています。



News Release

Amkor は、数十年にわたる自動車業界の経験を持つ業界一位の車載用 OSAT 企業です。Amkor は、韓国の R&D センター・オブ・エクセレンスを含め、欧州、日本、東南アジアに戦略的に製造拠点を構え、自動車業界の厳しい性能・信頼性の要求を満たすために役立つファクトリーオートメーションやその他の Industry 4.0 に向けた投資を続けています。米国に本社を置く Amkor は、市場の成熟に伴い、米国でパワーモジュール製造を含む車載用ソリューションを追加するのに適した位置にあります。グローバルなサポートと現地拠点で、Amkor は地域の自動車メーカーがサプライチェーンの安定性を確保し、競争力を維持できる次世代の自動車ソリューションの提供を追求するための支援を行います。

「Amkor には、自動車業界において信頼できるパートナーとしての長い実績があり、リーダーシップを発揮してきた歴史があります」と Amkor のビジネスユニットのエグゼクティブ・バイスプレジデントである Kevin Engel は述べています。「これは、インフラストラクチャと研究開発への継続的な投資、品質第一の姿勢、そして未来の自動車の実現を支援する独自の地位を築く技術的リーダーシップがもたらした結果です。」

NVIDIA の自動車ハードウェア・システム担当シニア・バイスプレジデントを務める Gary Hicok 氏は、「業界がソフトウェアで動く自動車へと移行する中、今日の自動車の高度な運転システムはより大きな処理能力を必要とし、堅牢なデバイスパッケージングを備えた非常に複雑で高度なテクノロジープラットフォームの必要性が高まっています」と述べています。「その洗練された設計とパッケージング機能で、Amkor は信頼できる車載用パッケージングテクノロジープロバイダーとなっています。」

自動車業界向けの Amkor の能力の詳細については、amkor.com/automotive/をご覧ください。

Amkor Technology, Inc.について

Amkor Technology, Inc. は、半導体パッケージングおよびテストサービスのアウトソーシングを提供する世界最大手のプロバイダーのひとつです。1968 年に設立された Amkor は、IC パッケージングとテストのアウトソーシングのパイオニアであり、現在では世界の主要な半導体企業、ファウンドリ、エレクトロニクス OEM の戦略的製造パートナーとなっています。Amkor は、アジア、ヨーロッパおよびアメリカといった世界の主要なエレクトロニクス機器製造地域に、製造拠点、製品開発センター、営業オフィスを構えています。詳細については、amkor.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述の免責事項

このプレスリリースには、自動車における半導体コンテンツの成長および期待される成長を支えるための投資に関する記述など、連邦証券法で規定されている将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないように注意してください。このプレスリリースに含まれるすべての将来の見通しに関する記述は、当社の現在の期待、予想、推定、および仮定に基づいて作成されています。このような記述には、リスクと不確実性が含まれているため実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で予想されたものとは大きく異なる場合があります。これらの記述に含まれる事象の結果に影響を与える可能性のあるリスク要因については、証券取引委員会に提出または提出される当社の報告書に記載されています。当社または当社の代理人による将来の見通しに関する記述は、すべてこの注意書に



News Release

よってその全体が明示的に認定されます。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降に発生した事象や状況を反映させるために、いかなる将来予想に関する記述の見直し、更新する義務を負いません。

連絡先

投資家向け広報窓口

Jennifer Jue

投資家向け広報兼財務担当、バイスプレジデント

+1-480-786-7594

jennifer.jue@amkor.com

報道関係者向け窓口

Christina Parsons

マーケティング・コミュニケーション部長

+1-480-786-7653

christina.parsons@amkor.com

ソーシャルメディア：@amkortechology